รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดปฏิบัติการเชื่อมชิปขนาดไมโครเมตรบนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนการสอน (Die Bonder) จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

1.	การเคลื่อนที่ในแนวแกน XY ของฐานวางชิ้นงาน	220 mm x 220 mm
2.	การเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ของหัวจับชิ้นงาน	95 mm
3.	การหมุนของหัวจับชิ้นงาน	360°
4.	แรงกดของหัวจับชิ้นงาน	20g – 400g
5.	ความละเอียดในการวัดแกน Z	± 0.001 mm
6.	ฐานวางชิ้นงานสามารถรองรับขนาดของชิ้นงานได้สูงสุด	400 mm x 280 mm
7.	ความแม่นยำของการวางชิ้นงานลงบนฐานรองชิ้นงาน	±10 μm
8.	ความร้อนสูงสุดของฐานวางชิ้นงาน	400 °C
9.	มีหน้าจอแสดงผล	21 นิ้ว
10.	มีกล้องไมโครสโคปสำหรับดูชิ้นงาน	
11.	ขนาดของตัวเครื่อง	1155 mm x 790 mm x 728 mm
12.	มวล	95 kg
13.	รองรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับความดัน	220 โวลต์

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. .....ประธานกรรมการ
2. .....กรรมการ
3. .....กรรมการ